

2025 年 9 月吉日

御 得 意 様 各位

無料 Web セミナー
「ゲームもパワーデバイスも進化の鍵は UBM」
無電解めっきプロセスが拓く半導体実装技術の最前線

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、9 月 18 日に無料 Web セミナーを実施する運びとなりました。
開催概要やご参加の方法は下記の通りとなります。

【開催概要】

ゲーム機の進化を支えてきた実装技術は、今やパワーデバイスの信頼性にも深く関わっています。
本 Web セミナーでは、ゲーム技術の裏側にある半導体実装技術の進化を振り返りながら、UBM（Under Bump Metal）形成技術の最新動向、EV や再生可能エネルギー分野で求められるパワー半導体の技術課題について解説します。
当社が開発した無電解めっきによる UBM 形成技術は、Ni/Pd/Au 三層構造による高品質な厚膜金めっきを実現し、高温環境下での安定性といったパワー半導体特有の課題を解決します。
技術者の方はもちろん、製造・開発・営業など、幅広い職種の方にとって学びのある内容です。ぜひご参加ください！

開催日：2025 年 9 月 18 日（木）
時 間：11:00～ （約 40 分）※日本時間
費 用：無料
形 式：Web セミナー（Zoom 使用）
講 師：営業部 西日本営業課 九州エリア 和田 崇

【お申込み方法】

下記リンク先のお申込みフォームよりご登録ください。
<https://www.meltex.com/registration.html>

【お問合せフォーム】

なお、Web セミナーや、その他弊社製品についてのご質問がございましたら、下記のお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様からのお問い合わせには、メールにてご返信いたします。
<https://www.meltex.com/contact.html>

今後ともよろしくお願いいたします。

敬具